

**TOPPAN、「JAPAN PACK2025[日本包装産業展]」に出展**  
社会の持続可能な未来に向けて貢献する DX ソリューションの最新事例を紹介  
特別展示「包装ライフサイクルコーナー」「CLOMA パビリオン」にも参加

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:大矢 諭、以下 TOPPAN)は、2025年10月7日(火)から10日(金)に東京ビッグサイトにおいて開催される「JAPAN PACK2025[日本包装産業展]」に出展します。

TOPPAN ブース(東展示棟8ホール8-313)では、「製造・物流における課題解決をDXによる“トータルサポート”で寄り添う」をコンセプトに、製造現場のデジタル化を支援する製造 DX ソリューション「NAVINECT®」を始めとしたサービスを展示し、製造業に向けたDX(デジタルトランスフォーメーション)を紹介します。

また、TOPPAN ブースの他に、特別展示である「包装ライフサイクルコーナー」「CLOMA パビリオン」にも参加・出展し、パッケージによる環境に配慮した社会の実現に向けた、GL BARRIER(※1)、再生材活用パッケージなどの TOPPAN サステナブルパッケージソリューションを紹介します。



TOPPAN ブースイメージ© TOPPAN INC.

## ■ 主な展示内容

TOPPAN ブースでは、食品・日用品・流通・医薬を始めとした様々な業界の製造・物流現場に向けたデジタル化支援のサービスを展示します。

### ・製造 DX 統合 IT ソリューション「NAVINECT®」

「NAVINECT®(ナビネクト)」は、製造業のDXに必要な12種類のパッケージにより、製造現場の課題を解決します。TOPPAN 自社開発のアプリケーションと装置やデバイスを組合せ・連携することで、柔軟かつフリーズナブルにDXを推進可能です。製造現場へのシステム導入は、工場実務経験とITスキルを併せ持つエンジニアリング陣が支援し、導入後の運用面もサポートします。

### ・スマート点検支援サービス「e-Platch®」

「e-Platch®(イープラッチ)」は、IoT向け無線通信規格 ZETA の特長を活かして TOPPAN が開発した工場の点検業務支援サービスです。点検に掛かる作業工数の削減や、構内移動・高所作業も削減し、労働時間や労働環境の改善に貢献します。低電力で駆動する ZETA 通信により、工場内外の計測器のデータを無線で収集、遠隔監視します。工場だけでなく倉庫・電力施設・ビルなど様々な施設で活用が可能です。

## ・その他の展示サービス

温度センサー搭載 RFID をはじめとする RFID ソリューション、物流・倉庫業務の効率化を実現するデジタルピッキングシステムなど、製造現場の課題をデジタル技術で支援する各種サービスを展示します。また、AI 活用による経営・事業変革支援に関して株式会社 INDUSTRIAL-X との協業による特別展示を行います。

### ■ 「包装ライフサイクルコーナー」について（場所：東展示棟 7 ホール 7-916）

主催者の一般社団法人 日本包装機械工業会による、Circular Economy と Carbon Neutral の実現に向け「C」でつなぐ未来の循環をテーマとした、「包装ライフサイクルコーナー」について、TOPPAN は同コーナーを監修するとともに、展示に参加します。同コーナーでは、国内外の社会動向を踏まえた 2030 年までのマイルストーンや、6 つの包装ライフサイクル（調達、設計・製造、充填・包装、使用、回収・排出、再生）に関連した事例を、実物製品も交えて紹介します。

TOPPAN は同コーナーにおいて、CO<sub>2</sub>排出量削減に向け、GL BARRIER を活用した各種バリア包材、単一素材を用いてリサイクル適性を向上させるモノマテリアル包材とともに、プラスチック資源循環に貢献する再生材活用パッケージといった、サステナブルパッケージソリューションを提案します。

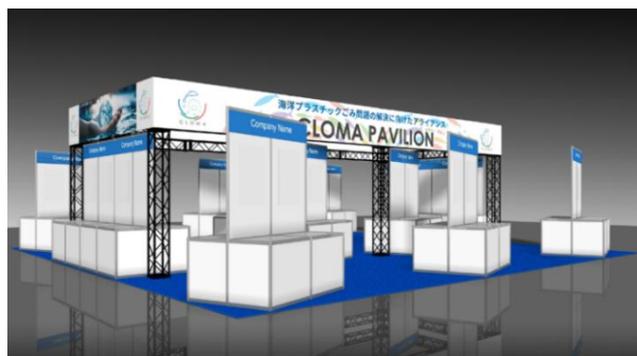


特別展示「包装ライフサイクルコーナー」ブースイメージ

### ■ 「CLOMA パビリオン」について（場所：東展示棟 7 ホール 7-915-26）

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)会員企業・団体が集い、「新素材・代替素材の提案」「プラスチックの適正使用」「環境配慮設計」「廃棄ロス削減」「3R+Renewable の推進」「環境デジタルソリューション」といった、容器包装のこれからの役割や付加価値（イノベーション）、トレンドなどを訴求する同パビリオンに、会員企業である TOPPAN も参加します。

TOPPAN は、CLOMA が、容器包装プラスチックへの再生材使用率を 2030 年までに 30%とするマイルストーン「Circular 30 by 30」を設定している中、シーラント用リサイクルポリエチレンフィルムとリサイクル PET フィルムとを組み合わせることで、パウチに使用するフィルム全体の再生材使用比率約 30%を実現したパッケージとともに、パッケージの主要フィルムの一部を再生材に置き換え、再生材活用フィルムの社会実装を促進する取り組みなどを提案します。



「CLOMA パビリオン」ブースイメージ

## ■ 展示会概要

名称： JAPAN PACK2025[日本包装産業展]

会期： 10月7日(火)～10日(金) 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト 東展示棟 4～8ホール

TOPPAN ブース (東展示棟 8ホール 小間番号 8-313)

主催： 一般社団法人 日本包装機械工業会

概要： 国内外の包装機械、包装資材、包装材料加工機械、食品加工機械、医薬品・化粧品・日用品製造機器、物流機器、それらに関連する技術・サービスを展示公開。

展示会 URL: <https://www.japanpack.jp/>

### ※1 GL BARRIER

TOPPAN が開発した世界最高水準のバリア性能を持つ透明バリアフィルムの総称です。独自のコーティング層と高品質な蒸着層を組み合わせた多層構造で、安定したバリア性能を発揮します。また多くの優れた特性が高い評価を受け、食品から医療・医薬、産業資材に至る幅広い分野で採用されています。印刷基材とバリア基材の双方の機能を兼ねることなどにより、アルミ箔代替、層構成の合理化を図ることができます。

URL: [https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/products/barrier\\_film/](https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/products/barrier_film/)

\* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

\* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上